

壹、致股東報告書

於民國 112 年股東常會

各位股東女士、先生，大家好：

2022 年，國際經濟持續受到通膨、烏俄戰爭、美中對抗、升息、匯率不穩定及海峽兩岸緊張局勢等不利因素的影響，整體市場需求急速萎縮，加上廠商急於去化庫存的持續發酵，半導體產業面臨十幾年來最嚴峻的挑戰；目前各電子產業復甦步調不一，延長了客戶產品庫存調整的時程，業界普遍認為產業景氣要到 2023 年下半年才會逐漸好轉。

力成集團為因應此嚴厲的挑戰，除嚴控成本及縮減資本支出金額外，更重新審視生產流程以優化產品組合，加速高階邏輯等高附加價值產品的認證及生產。2022 年度，在客戶及供應商的支持以及全體同仁的共同努力下，合併營收再次交出自公司創立以來最佳的成績，達到新台幣 839.27 億元；而歸屬於母公司的稅後淨利金額為新台幣 86.87 億元，每股盈餘(EPS)為新台幣 11.60 元，因此，為感謝股東們長期的支持，董事會更通過決議今年配發現金股息每股新台幣 7 元，鑒請股東會決議核准。

在面對這一波的世界變局中，力成過往採取的人才培育、組織改造及優化事業單位營運等措施，在集團各公司的分工下，已陸續看到成果：超豐電子專注於提供中低端產品的封測服務；Tera Probe / TeraPower 加強與日本及歐美等國際客戶關係的提升，拓展邏輯晶圓及成品測試；力成則在既有記憶體的先進封測技術基礎上，持續開拓高階邏輯及異質整合的技術、產品與客戶；目前 bumping、WLP 及 Flip Chip CSP/BGA 製程量產順利，FOPLP (Fan-out Panel Level Packaging) 及 CIS TSV CSP 製程，已陸續於 2022 年加入生產營運，運用先進封裝技術客製化組合的 SIP/SIM/Sub-system 正與客戶持續探討一同開發未來的新產品，預期將來導入量產後，有助於公司業績的永續成長。

展望新的年度，新的高階電子產品應用，如：AI 人工智慧、5G 通訊、無人車或載具及高速運算(HPC, High Performance Computing)產品等，將相繼推陳出新，對先進封測製程的需求會持續暢旺，力成集團將專注此一未來趨勢，持續與客戶及供應商進行深入且密切的合作，我們將專注於：

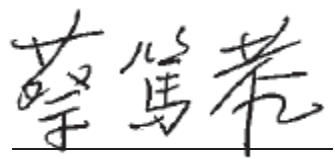
1. 持續保持記憶體產品在品質、技術及產能的世界領先地位；
2. 新技術業務拓展：專注於 bumping、邏輯 Flip Chip CSP/BGA、量產 FOPLP 及提供 Fan-Out on wafer 之認證；
3. 先進技術的研發及製造：發展以 TSV 為連結的高性能產品，如車用及安全使用的 CIS CSP 及 HBM (High Bandwidth Memory)；

4. 定期檢視 ESG(環境、社會及公司治理)之短、中長期計畫及相關的關鍵指標，以落實企業永續發展，並加強對外揭露相關資訊與執行措施，以供利害關係人了解。

力成感謝股東及客戶的支持，全體同仁努力且勤奮地走過四分之一個世紀，未來仍將堅持朝「技術、品質及服務世界第一」的目標前進！

再次謝謝各位股東對力成集團全體員工及經營團隊的支持與鼓勵！

祝 大家身體健康，萬事如意

董事長： 

蔡篤恭

力成科技股份有限公司

—— 111 年度營業報告書



一、111 年度營業報告書

根據國際貨幣基金組織(International Monetary Fund, IMF) 112 年 1 月之「世界經濟形勢與展望」報告指出，111 年全球經濟成長率為 3.4%，112 年預計將降至 2.9%，113 年升至 3.1%，112 年和 113 年的全球經濟成長率預計將低於 3.8% 的歷史(89-108 年)年均水平。這是自 90 年以來除全球金融危機和 COVID-19 後最疲弱的增長表現。全球經濟活動正在經歷放緩且情形比預期更為嚴重，通貨膨脹率正處於幾十年來最高水準。利率升高和俄羅斯入侵烏克蘭，仍可能對經濟活動造成壓力。中國宣布經濟解封，預料也將貢獻全球經濟成長。IMF 預測 112 年全球平均通膨率達 6.6%，113 年再降到 4.3%，仍高於疫情前(106 - 108 年)之 3.5% 的水準。

在全球半導體的表現方面，根據國際研究暨顧問機構顧能(Gartner)調查結果顯示，111 年下半年由於全球經濟迅速惡化，通膨及升息等因素影響消費者需求減緩，短期前景已經惡化，恐將對 112 年的半導體市場產生負面影響，然而，在企業網路、運算、醫療及商業運輸等企業動能市場，則仍具有彈性。總計 111 年全球半導體營收為美金 6,017 億元，較 110 年小幅增加 1.1%。在台灣半導體產業表現方面仍然明顯優於全球，工研院產科國際所於 112 年 2 月統計：111 年台灣 IC 產業產值達新台幣 48,370 億元，較 110 年成長 18.5%，其中 IC 封裝業產值為新台幣 4,660 億元，較 110 年成長 7%，IC 測試業產值為新台幣 2,187 億元，較 110 年成長 7.7%。

因應半導體應用產品多樣化，帶動記憶體應用更廣泛，本公司持續發展封裝技術、並開發新製程及其相關的技術能力，全力滿足客戶需求。即便 111 年下半年半導體市況下行，消費性電子產品需求疲軟，但車用電子、伺服器、高速運算及人工智慧(AI)等客戶端之需求仍持續成長，力成在先前奠定的穩固基礎上，近年致力於新產品、新技術與新客戶的開發，產生的效益將使前述影響控制在可被接受的範圍，力成今年整體營收及獲利仍較去年小幅成長。未來我們仍將採取持續深耕技術、提供優良品質與服務並擴充產能，以滿足客戶需求並取得客戶的信賴，同時因應市況變化，縮減資本支出及嚴格控管營運成本，期待 112 年下半年經濟景氣的回升。

茲將本公司 111 年度的營運成果報告如下：

(一)111 年度營業實施情形

本公司 111 年度合併營收為新台幣 839 億 2 仟 7 佰萬元，較 110 年度的新台幣 837 億 9 仟 4 佰萬元成長 0.16%；在盈餘方面，111 年度合併稅後純益中歸屬於母公司股東的金額為新台幣 86 億 8 仟 7 佰萬元，較 110 年度之淨利新台幣 88 億 9 仟 8 佰萬元減少約 2.37%。

(二)財務收支情形

111 年度合併現金流量狀況：(單位：新台幣)

a.營業活動之現金淨流入	22,922,620 仟元
b.投資活動之現金淨流出	18,927,395 仟元
主要係取得不動產、廠房及設備	
c.籌資活動之現金淨流出	6,760,954 仟元
主要係配發股東現金股利及償還銀行借款	

(三)獲利能力分析

分析項目 \ 年度		111 年度	110 年度
獲利能力	營業利益 / 實收資本比率	163.97%	186.42%
	稅前純益 / 實收資本比率	179.67%	188.74%
	資產報酬率	9.22%	10.48%
	股東權益報酬率	16.59%	19.27%
	純益率	10.35%	10.62%
	每股純益	11.60 元	11.54 元

(四)研究發展狀況

本公司持續投入大量資源於新技術的研發與創新，111 年度研究及發展費用約為新台幣 24.62 億元，約占全年合併營收的 2.93%。在現有的記憶體及邏輯產品封測技術的基礎下，積極開發先進封測及異質產品整合技術，包含銅柱凸塊(Copper Pillar Bump, CPB)、晶片級覆晶封裝(Flip Chip CSP, FCCSP)、大尺寸球閘陣列覆晶封裝(Large Flip Chip Ball Grid Array, Large FCBGA)、系統/模組級封裝(SiP/SiM)、內嵌天線封裝/天線模組 (Antenna in Package / Antenna in Module, AiP/AiM)、高頻寬封裝堆疊 (High Band Package on Package, HBPOp)、內嵌散熱片晶片級覆晶封裝(Embedded Heat Sink Flip Chip CSP, Embedded H/S FCCSP)、晶圓級封裝(Wafer Level Package, WLP)、CMOS 影像感測器(CMOS Image Sensor Chip Scale Package, CIS CSP)、2.5D/3D TSV 及扇外型晶圓級/面板級封裝(Fan-Out Wafer/Panel Level Package, FOPLP)等封裝技術，為客戶提供全方位的解決方案。隨著 5G 天線封裝(5G Antenna in Package, AiP)技術開發及射頻(Radio Frequency, RF)實驗室啟用，目前已可提供 5G 封裝產品的驗證；在 CMOS 影像感測器(CIS)方面，則運用矽穿孔(TSV)連接技術，提升影像顯示之讀取速度，積極發展其應用於醫療、監控及車用的晶圓級晶片尺寸封裝；在高頻寬記憶體(High Bandwidth Memory, HBM)產品方面，也運用矽穿孔(TSV)之連接技術，提升記憶體產品之頻寬與速度，應用於高效能運算(High Performance Computing, HPC)產品與雲端伺服器；扇外型晶圓級/面板級封裝(FOWLP/FOPLP)方面，更因應後摩爾定律時代在晶片微縮(Chip Scaling)製程上所面臨的困難，積極密切的與客戶進行相關產品的開發及驗證。

二、112 年度營業計劃概要

(一)經營方針

- 1.重承諾(Promise)、創新技術(Technology)及提供整合(Integration)服務為公司的核心價值。
- 2.專注於半導體產品專業封裝及測試領域，與客戶及協力廠商共創利潤。
- 3.致力於先進技術的研發及適時的導入新產品，以提高企業成長動能。
- 4.以穩定的品質及精湛的技術提供客戶全方位的服務。
- 5.整合資源及強化經營績效，確保企業的獲利與永續經營。
- 6.培育人才及重視員工福利與股東權益，創造共享價值。

(二)預期銷售數量

依據世界半導體貿易統計(The World Semiconductor Trade Statistics, WSTS)於111年11月發布的112年半導體銷售預測，112年全球半導體市場將衰退4.1%，銷售金額約5,570億美元，其中記憶體產品將是其中衰退最主要的部分，為年減17%。針對台灣地區的半導體產業發展，雖然來自全球通貨膨脹、連續升息、烏俄戰爭及地緣政治等因素影響嚴峻，但工研院產科國際所預期，台灣半導體產業仍然將持續成長，112年台灣IC產業產值年增率將優於全球，達到6.1%，產值達到新台幣5兆元，顯示出台灣半導體產業強韌的全球競爭性。

展望112年，隨著5G產品應用的愈益普及，以及各類型新興的應用，包含人工智慧(AI)、電動車、自駕車、資料中心、遠距教學、低軌道衛星、電子醫療、家用電子產品及各式行動裝置的創新功能推陳出新，半導體將依然是ICT產業的領頭羊，成長性依然可期。

COVID-19的影響已走入尾聲，疫情對全球經濟的影響逐漸消退，112年全球都將回復到疫情前的生活型態。值得注意的是，地緣政治與全球貿易摩擦的情勢依然嚴峻，對整體經濟市場的影響必須密切觀察。

預估今年各式產品的生產量，不管是邏輯晶片封測市場，或記憶體產品晶片封測市場皆需考量需求面及庫存去化的速度，預估較為保守，112年各類產品的預測生產數量如下表：

銷售項目	預計銷售數量
封裝	約 160 億顆
測試	約 100 億顆
晶圓級封裝	約 100 萬片
晶圓測試	約 320 萬片
固態硬碟(SSD) + 薄型固態硬碟系統整合封裝(SiP)	約 1.2 億顆

(三)重要產銷政策

- 1.提供一元化(Turn-key)的客戶服務以縮短交期及降低運送成本。
- 2.維持記憶體產品封裝測試服務的產業龍頭地位。
- 3.持續拓展邏輯產品(Logic)業務，並積極拓展覆晶封裝(Flip Chip, FC)、固態硬碟(SSD)、晶圓級封裝(Wafer Level Package, WLP)、晶圓級測試(Chip Probing, CP)、矽穿孔影像感測器晶片尺寸封裝(TSV CIS)、以矽穿孔為導通技術的多晶片記憶體堆疊(3D-IC memory stacking)、系統級封裝(System in Package, SiP)及扇外型封裝(Fan-Out Package)的業務成長。
- 4.進一步維持與現有客戶之長期合作關係，並積極拓展新市場、新應用、新客源及新產品的開發。
- 5.持續致力於產品的產品成本控制，充分利用並整合集團資源，以提升公司整體的競爭優勢。

董事長：



經理人：



會計主管：

